

折粒機
型號：NYB-900

NYB-900 折粒機為晶片電阻二次分割用，一次分割後之半成品需置入料盒內以真空濺鍍方式作端電極加工處理後，再以本機作二次分割加工。反面置入料盒之工件，本機可自動將其排除。

本機適各種尺寸之晶片電阻使用，高產能，易操作，易維護。

機械規格

產品尺寸：0402 切割線朝下、黑色面朝上，可互換

料盒尺寸：63W*12D*75H，可依客戶需求更改

處理能力：出料速度約 180 條/分

分割速度：3 - 35 公尺/分

分割皮帶組自動游走

皮帶尺寸：30W*800L(808L)

料盒更換：約 5.5 秒

料盒儲存：20 個

反面料處理：2 道 1.直接排除 2. 排除失敗停機

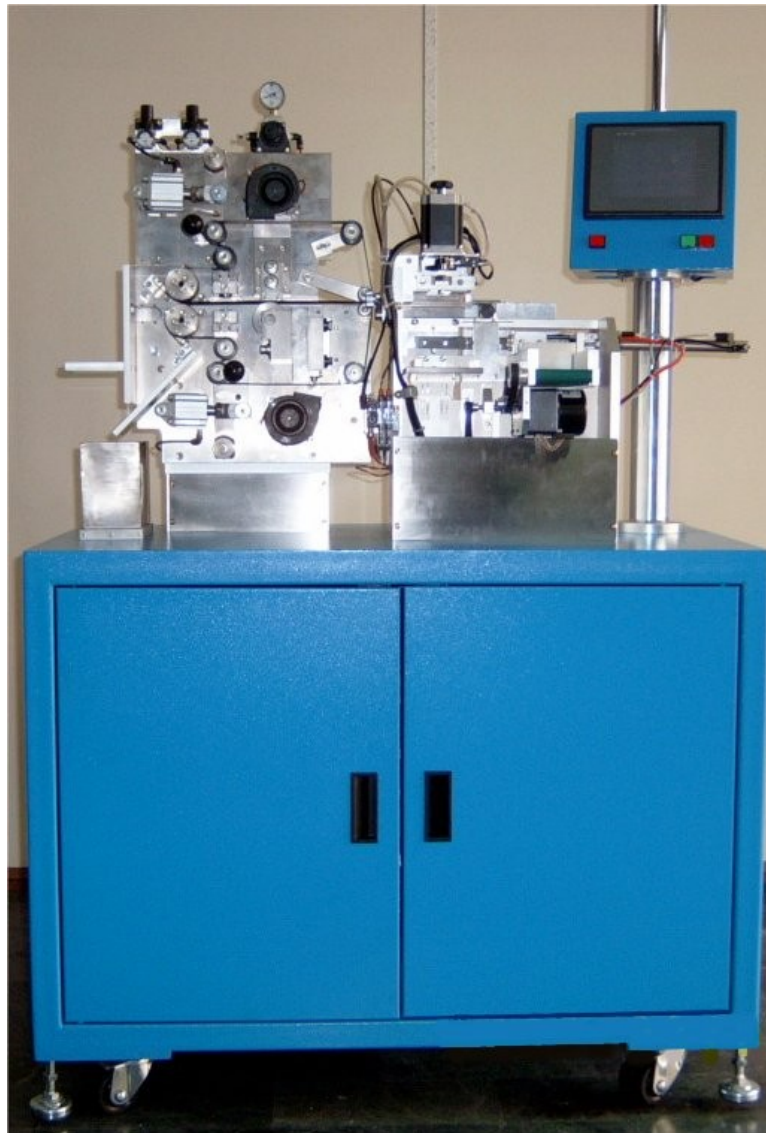
乾燥空氣：5 kg/cm²

機械尺寸：960W*580D*1,400H(不含指示燈塔)

960W*580D*1,850(含指示燈塔)

機械重量：約 200 kg

電源：AC220V 單相



聯絡資訊

捷坤企業有限公司

桃園市和愛街 11 號 1 樓之 2

電話：03-3554380

傳真：03-3268225

電子信箱：sales@jkp-tech.com

公司網址：<http://www.jkp-tech.com>